

MACUSPEC HT 300

电镀铜金属化

立即联系我们, 以了解如何在现有的直流电镀线中实现类似脉冲电镀线的性能。

- 实现更高技术的电路板制造
- 无与伦比的直流电镀产能, 可电镀高达15:1纵横比的通孔
- 非常适合用于通孔电镀, 盲孔一般电镀和图形电镀
- 药水添加剂可使用CVS和常用分析工具轻松的分析
- 可直接使用于既有直流电酸铜槽, 不需要昂贵的脉冲整流器设备投资
- 完全满足多层板工业标准如 IPC 6012D。
以IPC TM-650-标准测试方法测试拉伸强度
>36,000PSI, 延伸率>12%

